

2025年度会社説明会

日東電工株式会社

代表取締役 取締役社長 CEO COO

高崎 秀雄

取締役 専務執行役員 CTO

三木 陽介

2025年9月12日

Nitto

Innovation for Customers

1 中期経営経営計画 Nitto for Everyone 2025の進捗

2 インダストリアルテープ

3 オプトロニクス

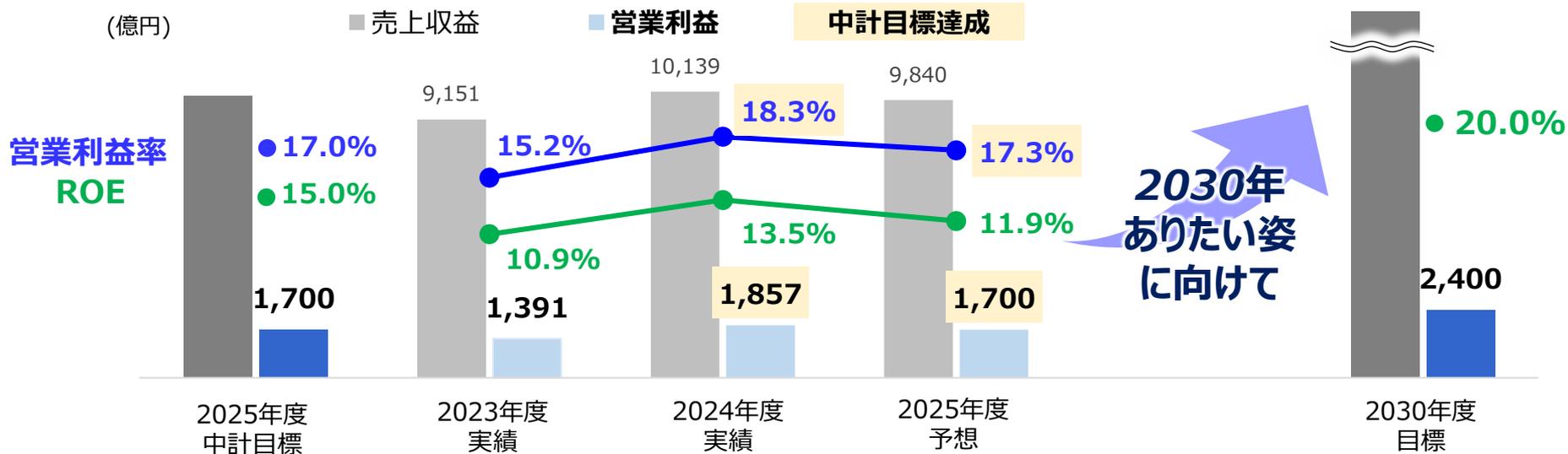
4 ヒューマンライフ

5 新規事業

1

中期経営経営計画 Nitto for Everyone 2025の進捗

2024年度は、過去最高業績を更新し、中計目標の営業利益(率)を前倒し達成
2025年度は、ROEの改善と次なる成長分野への資源投入を進める

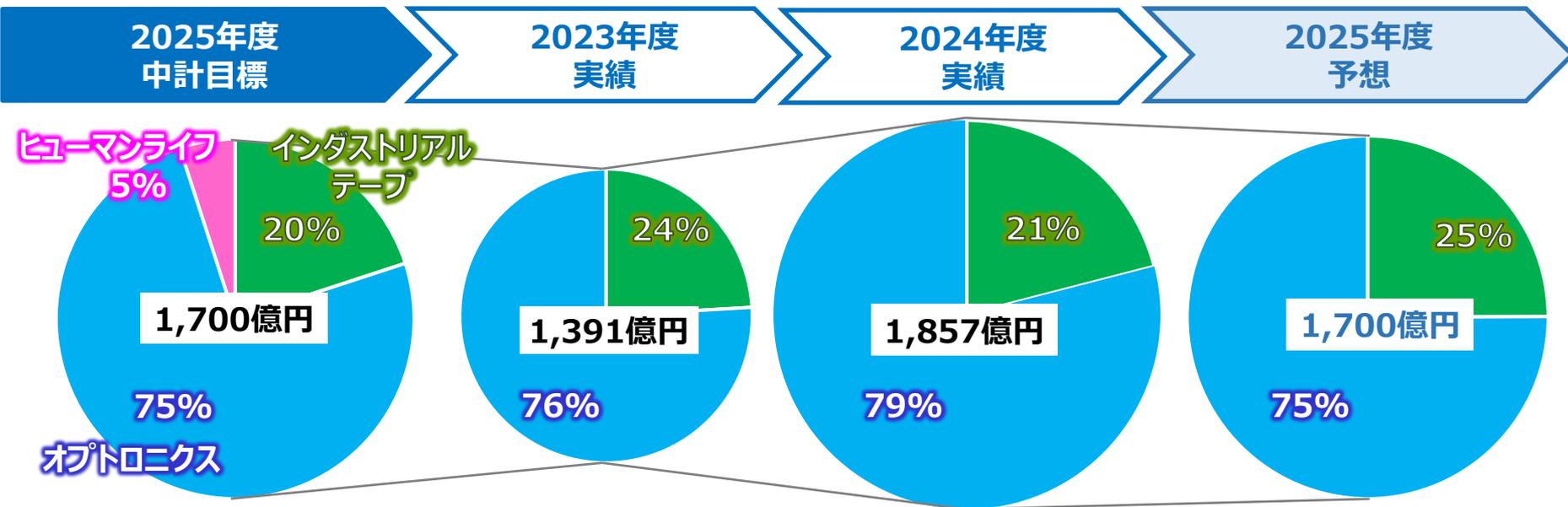


Nitto for Everyone 2025

新中期経営計画

事業ポートフォリオ(営業利益)の状況

依然としてオプトロニクスが主体。一方でインダストリアルテープが拡大
よりバランスの取れた事業ポートフォリオを目指し、ヒューマンライフの収益改善に取り組む



*全社/消去及びマイナスセグメントを含まない構成比

2025年度目標を一部前倒して達成。全項目達成に向けグループ一丸で取り組む

未財務目標

中計目標達成		2023年度 実績	2024年度 実績	2025年度 目標	2030年度 目標	2023年度 実績	2024年度 実績	2025年度 目標	2030年度 目標		
製品系	ニッチトップ売上収益比率 <small>なくてはならないNitto製品の拡大を計る指標</small>	44%	48%	50%	50%以上	人財系	エンゲージメントスコア <small>従業員の「帰属意識」「職場環境」「心身の健康」などを計る指標</small>	81	-	78	85
	PF/HFカテゴリ売上収益比率 <small>※PlanetFlags™/HumanFlags™ 環境・人類貢献製品の拡大を計る指標</small>	36%	44%	40%	50%以上		チャレンジ比率 <small>価値創造にチャレンジした従業員の割合を計る指標</small>	37%	41%	70%	85%
	新製品比率 <small>新製品の創出度合いを計る指標</small>	41%	41%	35%以上	35%以上		女性リーダー比率 <small>ダイバーシティの促進度合いを計る指標</small>	20%	22%	24%	30%
	廃プラスチックリサイクル率 <small>サーキュラーエコノミーに対する取組みの進捗を計る指標</small>	47%	50%	50%	60%						
環境系	サステナブル材料使用率 <small>環境配慮した材料の調達度合いを計る指標</small>	16% <small>※国内(単体)</small>	18% <small>※国内(単体)</small>	20%	30%						
	CO ₂ 排出量(Scope1+2) <small>カーボンニュートラルに向けた取組みの進捗を計る指標</small>	525 kton/年	472 kton/年	470 kton/年	400 kton/年						

設備投資へのキャッシュ配分は計画通りに進捗 M&A案件を継続検討するとともに積極的な株主還元を実施



2

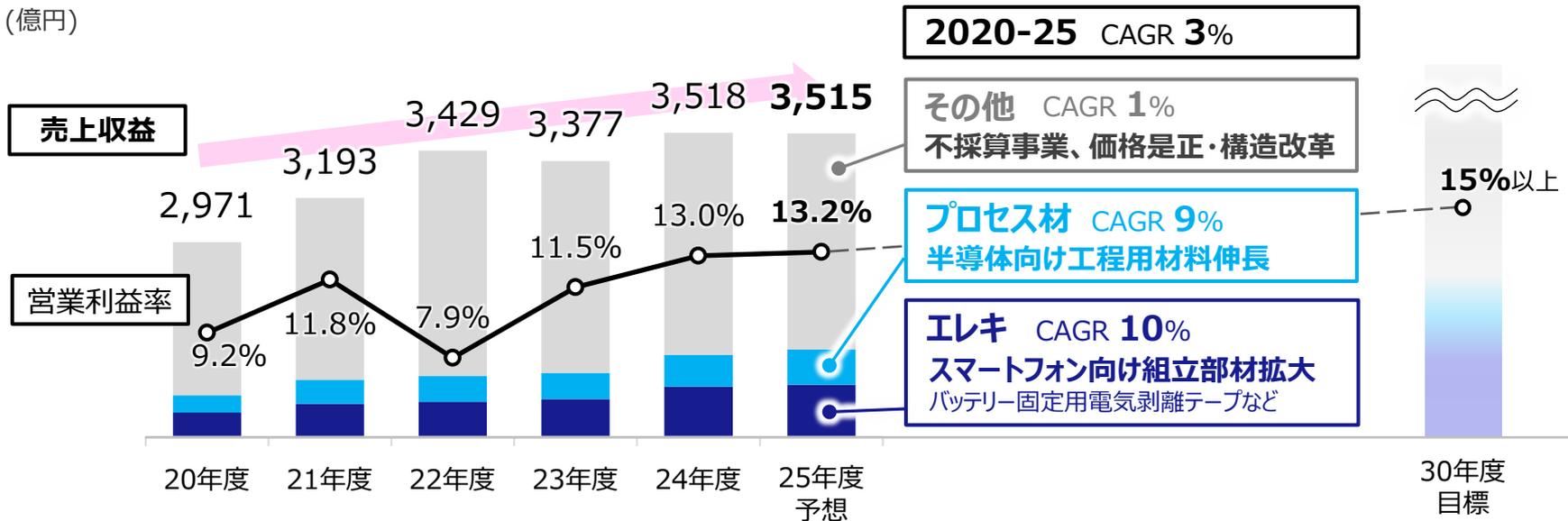
インダストリアルテープ

インダストリアルテープの成長推移

エレクトロニクス領域の売上成長と不採算事業の構造改革などにより
製品ポートフォリオが改善し営業利益率が向上 (FY20→25: +4.0%)

売上収益・営業利益率推移

(億円)



循環型社会に向けた変化を捉え、三新活動で事業拡大を図る

売上計画



技術展開

スマートフォン
(筐体・ディスプレイ固定)

接着 & 剥離
+
防水 & 防塵

スマートフォン(バッテリー固定)

接着 & 剥離
修理・交換
し易く

新需要創出

車載ディスプレイ・電子部品

接着 & 剥離
+
高耐久 & 超軽剥離

市場展開・顧客拡大

タブレット

イヤホン

循環型社会への法整備 “廃棄の削減、リサイクルの促進”

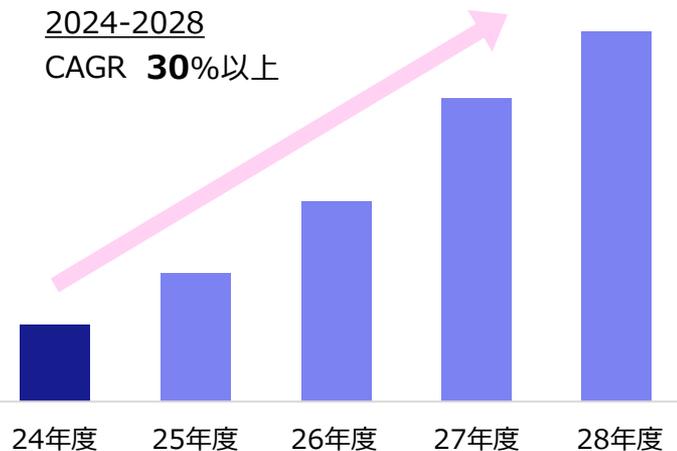


Nittoの剥離技術で先端半導体分野に貢献し、事業の成長を目指す

売上計画

先端半導体

2024-2028
CAGR **30%以上**



先端半導体の次世代積層技術を支えるNitto製品

	汎用半導体	先端半導体
用途	PC・家電など	ハイエンドスマホ・生成AI
ウエハの厚み	0.1mm~0.5mm	0.03mm以下
		低ダメージに加え、低汚染性が求められる

Nittoの剥離技術

低
ダメージ
↓
超低



UV剥離

薄化するウエハの加工・洗浄時の
耐薬品保護



UV・水剥離

糊残りによるウエハ表面の
汚染リスクを低減



新加熱発泡剥離

剥離ダメージを極限まで抑えることで
ウエハ加工時および積層時の歩留まり改善

3

オプトロニクス

今後の成長分野に注力し、さらなる高収益体質を目指す

営業利益率

18.8% → 31.9%

売上収益(億円)

4,289

5,430

売上構成比

36%

61%

成長領域

フォルダブル(COE)

車載向け偏光板

AR/AIスマートグラス

ハイエンドスマホ向け
高精度基板

HDD向けCIS

低誘電基板
半導体基板



2020年度



2024年度

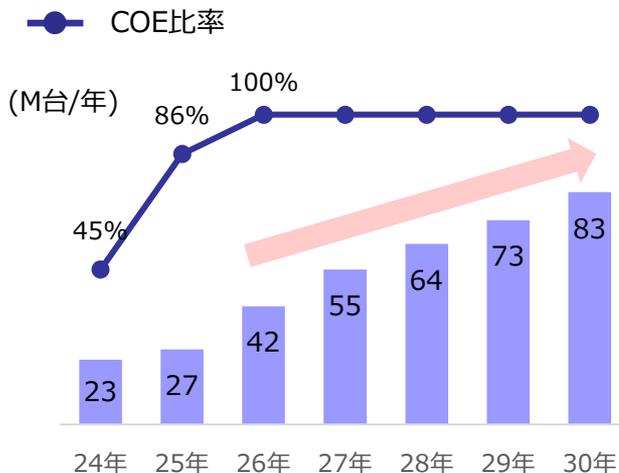
2030年度目標

フォルダブルの課題に対し、Nittoのトータルソリューションを提供

フォルダブル物量とCOE比率見通し

- ・AI搭載により端末の電力消費が増加
- ・消費電力抑制のためCOE化が進む

※COE(Color Filter on Encapsulation)=偏光板レス



フォルダブルの搭載点数・売上指数と技術課題

搭載点数：売上指数

※同じディスプレイ面積で比較

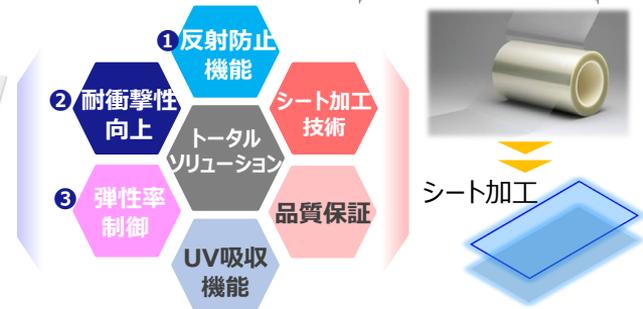
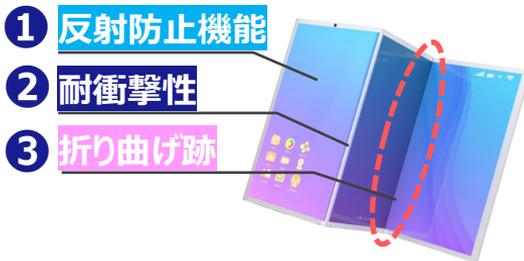
フレキシブルOLED

4点：1



フォルダブルOLED COE

5点：1.4

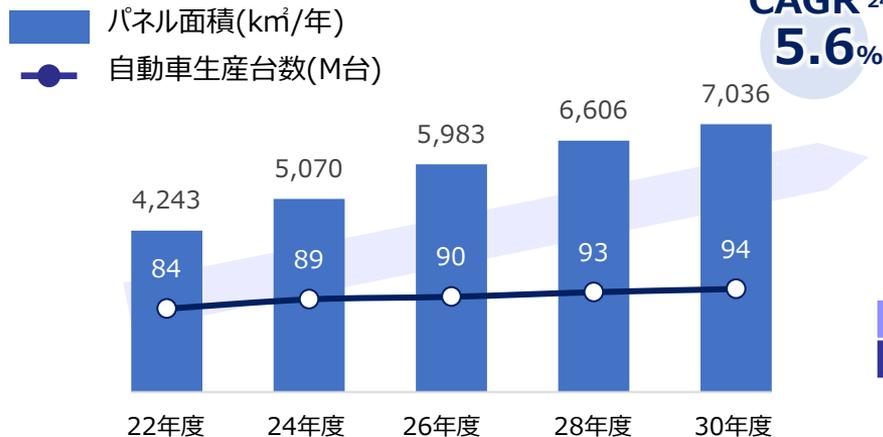


自動車生産台数は横ばいも、ディスプレイの面積拡大と搭載数の増加により
パネル面積が堅調に成長する見通し。さらに多商材化を図り、売上拡大を目指す

車載市場：自動車生産台数とパネル面積見通し

ディスプレイサイズ平均
24年:10.8" ▶ 30年:12.0"

1台当たりの搭載ディスプレイ台数
24年:2.4 ▶ 30年:2.6



車載コックピットにおける情報機能材料の商材

偏光板

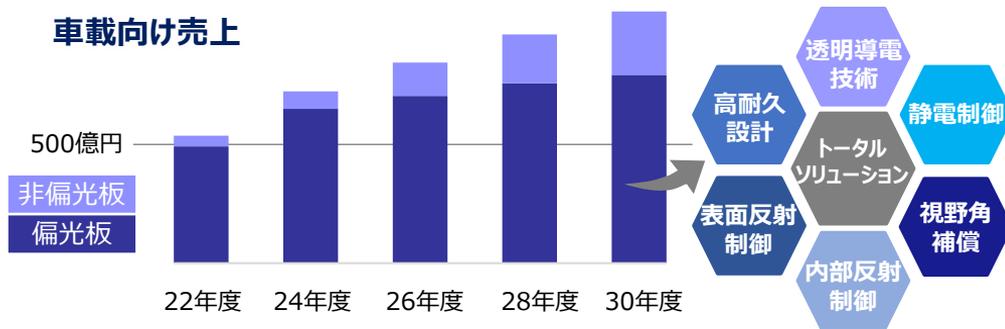


調光ITO

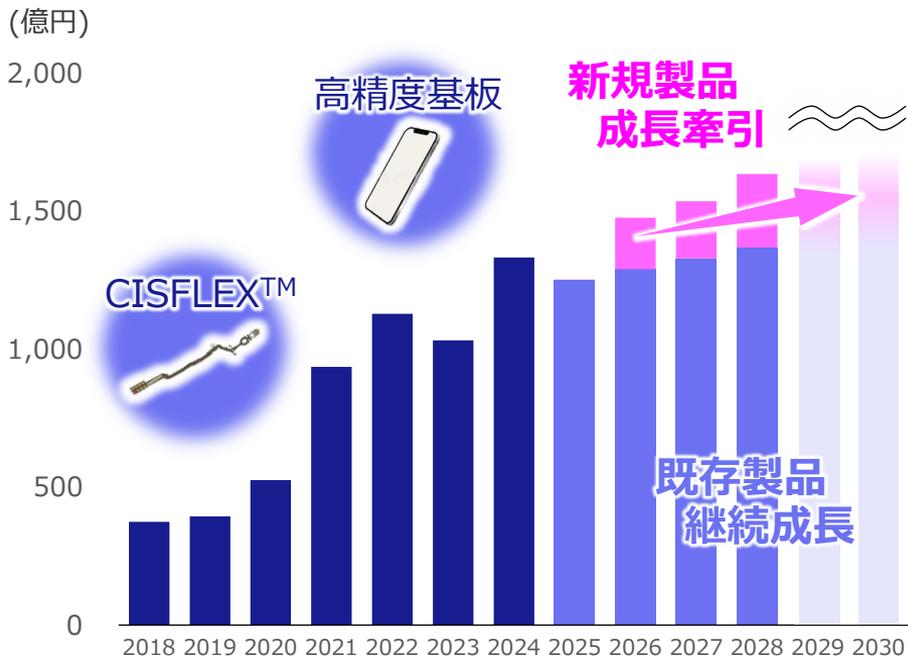
OCA

CAGR 24年度比
6.6%

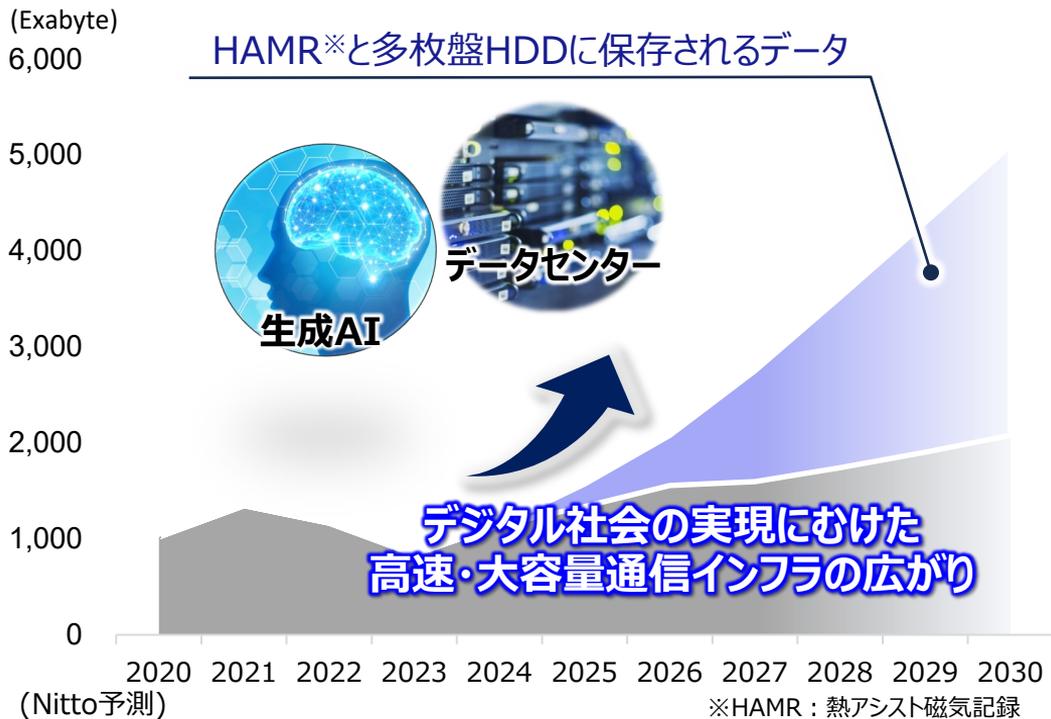
車載向け売上



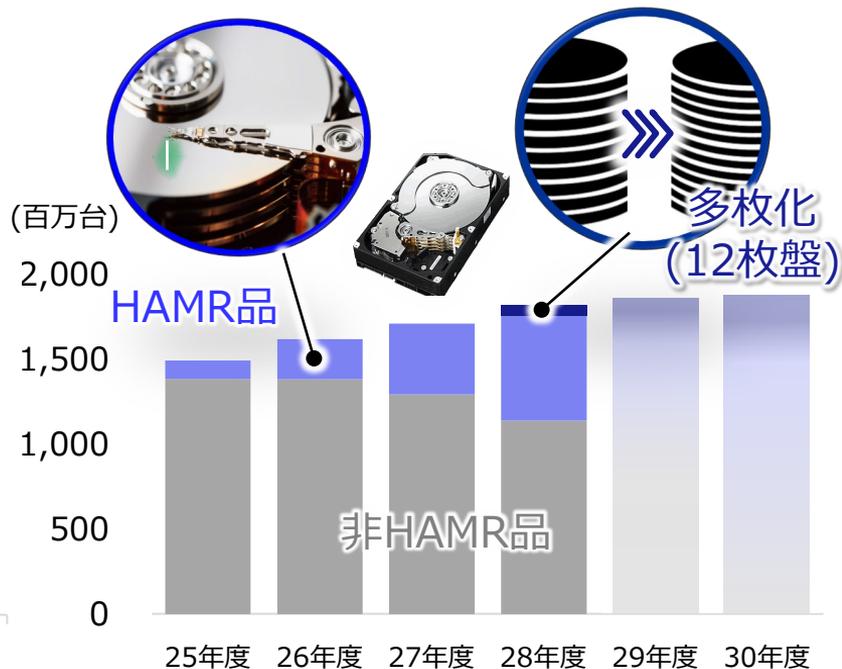
回路材事業の成長シナリオ



世界のデータ容量予測



CISFLEX™の販売数量予測



デジタル社会の課題

Nittoのソリューション

低誘電基板

部品点数増加

- ▶ スマホ内のスペース減少



高速通信規格の進化

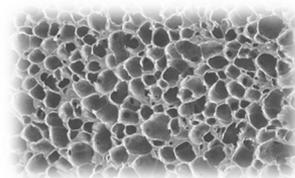
- ▶ 通信ロスの増大



薄型化で狭い
スペースにも対応



多孔ポリイミドで
ロスを低減



半導体基板

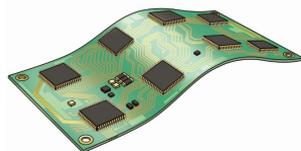
半導体の高性能化

- ▶ 信号の高速化

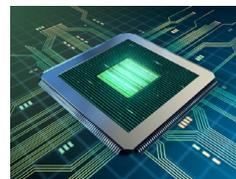


半導体の発熱

- ▶ 反りの発生



微細配線で
処理能力向上



金属材料で
反りに対応



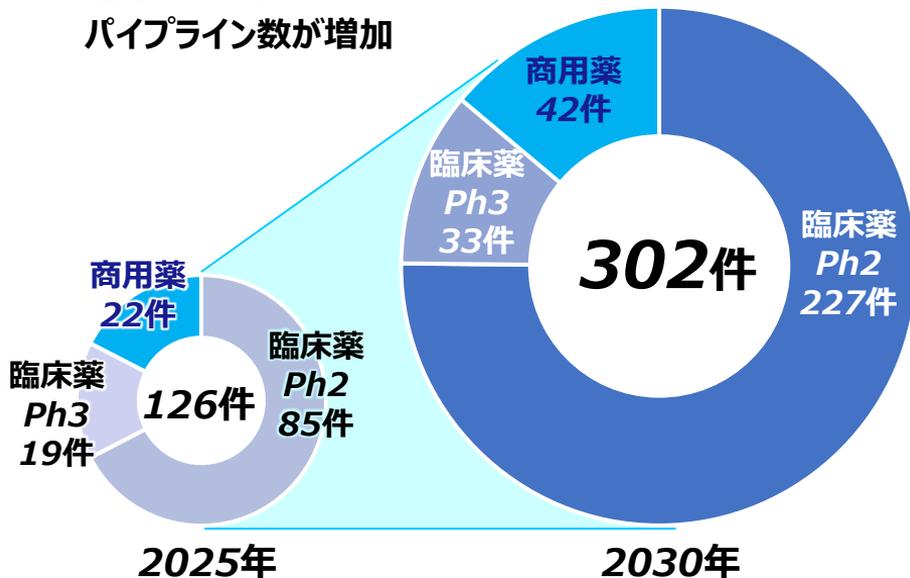
4

ヒューマンライフ

核酸医薬品のパイプライン数は今後も増加する見通し 大型疾患向け商用薬の拡大が受託製造市場の成長を牽引

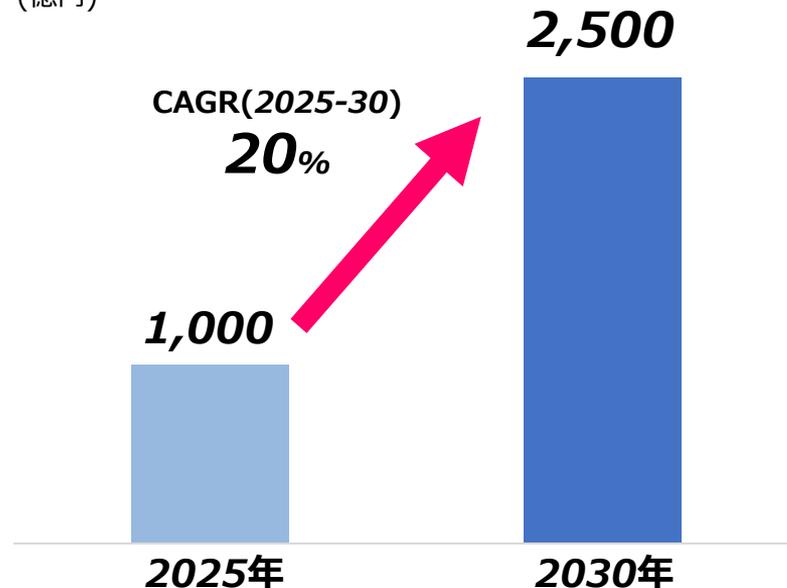
核酸医薬品パイプライン数の展望 件数：当社推定

適応疾患が拡大し製薬企業の
パイプライン数が増加



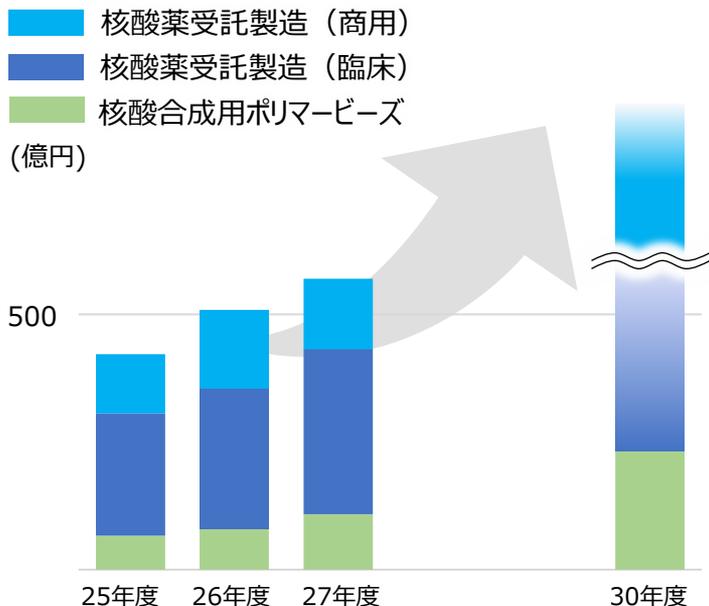
核酸受託製造市場規模 Evaluate社レポートより当社推定

(億円)



大型疾患領域での需要を戦略的に取り込み、2030年に向けてさらなる事業成長を実現

売上計画



当社が関与する主要案件

	顧客	疾患	段階	受託製造	ポリマービーズ
1	A社	代謝疾患	商用		●
2	B社	B型肝炎	Ph3 (新薬承認申請間近)	●	●
3	C社	代謝疾患	Ph3		●
4	D社	代謝疾患	Ph3		●
5	E社	代謝疾患	Ph2	●	●
6	F社	循環器疾患	Ph2	●	●
7	G社	循環器疾患	Ph2	●	●
8	H社	神経疾患	Ph2		●
9	I社	循環器疾患	Ph2	●	●
10	J社	代謝疾患	Ph2		●

環境配慮と高い適応力を兼ね備えた製造基盤で、核酸医薬品市場の成長を支える

生産能力4.8倍に増強し、2030年までの能力をカバー

宮城新工場

2024年度
稼働開始済

■ ポリマービーズ製造



NittoPhase™



■ ESG 太陽光発電と水素ボイラーのハイブリット設計

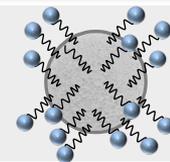
太陽光発電
+
余剰電力を水素に置換
水素ボイラーで熱源利用



サンディエゴ新工場

2026年2月
量産開始

■ ポリマービーズ加工



リンカー
(核酸合成の起点)

■ ESG CO₂ゼロエミッション、将来の溶剤リサイクルに対応

後工程の製造時に使った
廃有機溶剤をストック
↓
有機溶剤をリサイクル



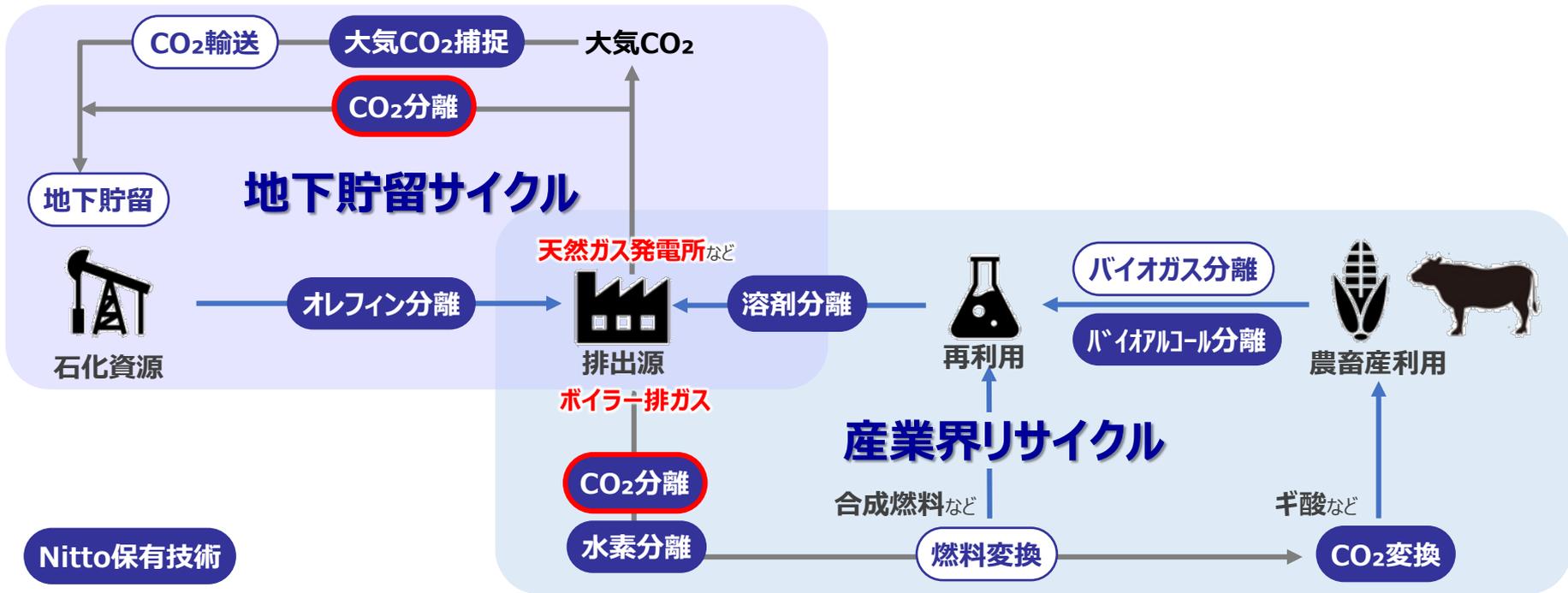
成長市場において技術優位性のある付加価値製品を展開



5

新規事業

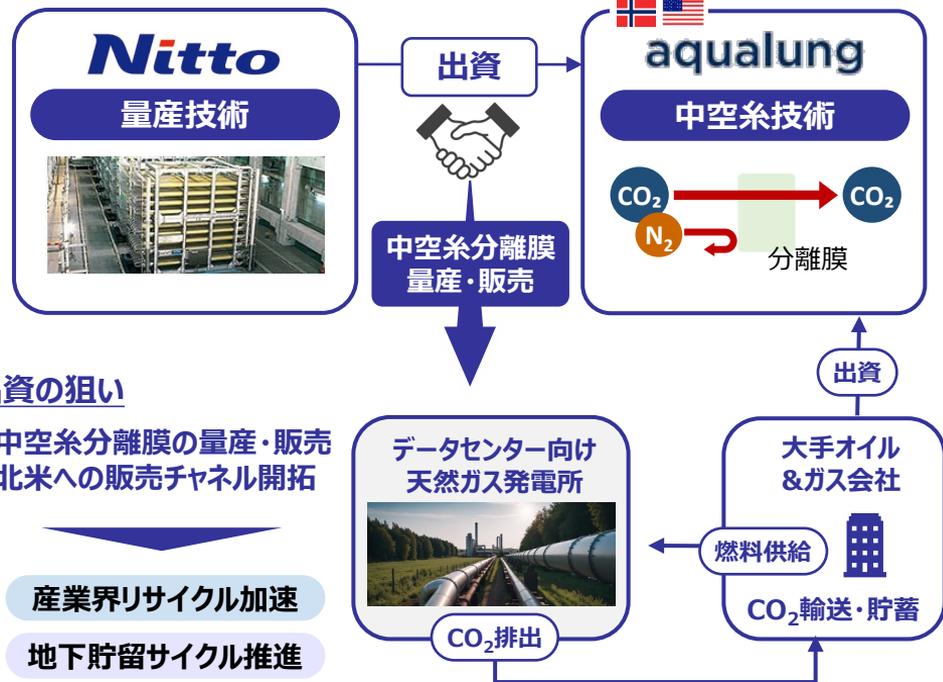
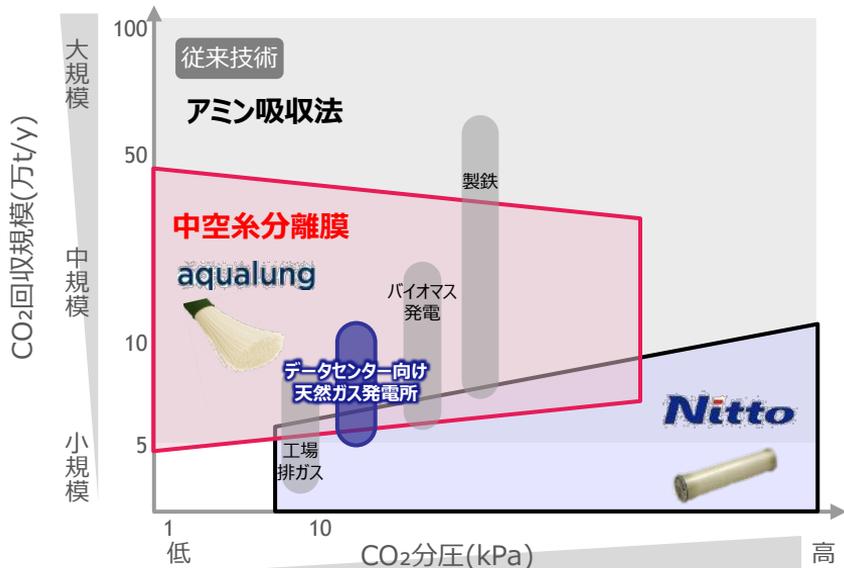
産業構造の大転換期に炭素循環に欠かせない価値を提供する



aqualung社への戦略的出資を行いCO₂分離膜事業を加速

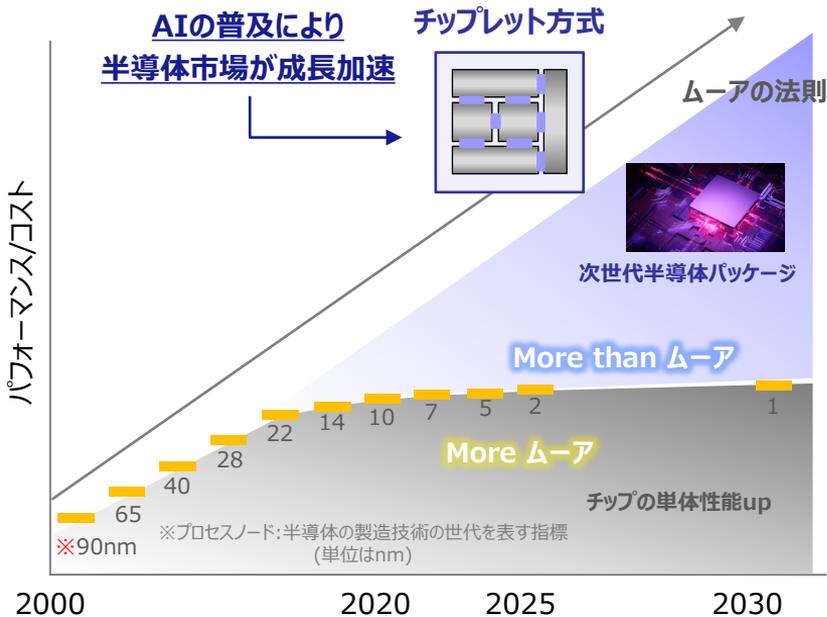
CO₂分離方式のポジショニング

アミン吸収法が不得意な領域を代替する技術

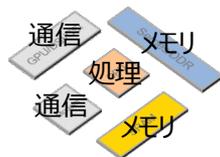


NittoとIBM社の技術を掛け合わせAI半導体領域で新需要を創出

半導体の変遷と成長

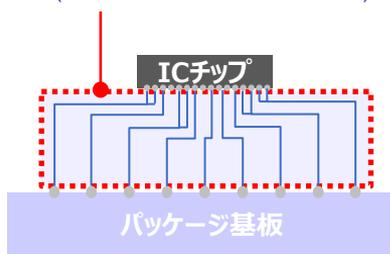


チップレット方式の導入



機能別に最適チップを
別々に作製して接続する方式

インターポージャー再配線層 (ICチップとパッケージ基板を繋ぐ役割)



24年6月～共同開発締結

Nitto

新規材料開発 モノづくりノウハウ

有機絶縁材料

RtoRプロセス



IBM社

先端半導体設計 最先端設備

半導体パッケージ設計

信頼性評価

Nitto

Innovation for Customers